

成熟的用于分立器件或功率半导体封装的高可靠性锡膏

NC-SMQ75

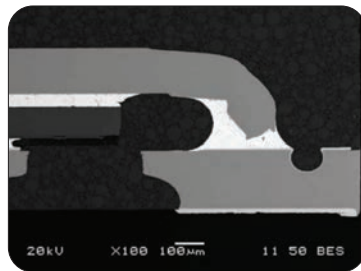
超低残留芯片贴装焊锡膏

- 行业领先
- 出色的工艺性能
- 超低残留
- 与塑封料兼容

与塑封料兼容

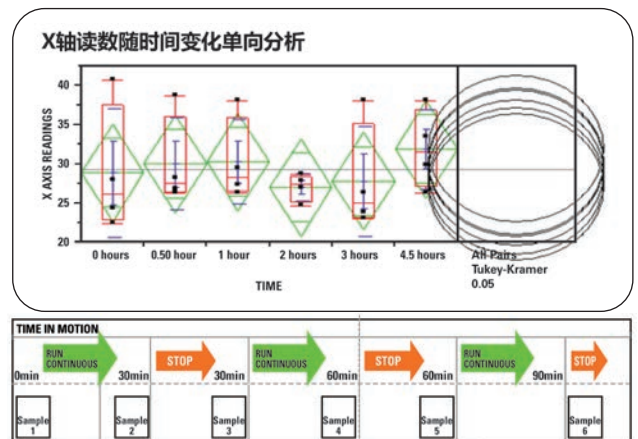
铜夹焊封装应用

- 1,000 次热循环 (-55 至 +130°C)
- SEM 截面分析
 - 无助焊剂残留迹象
 - 无分层



高一致的点锡膏特性

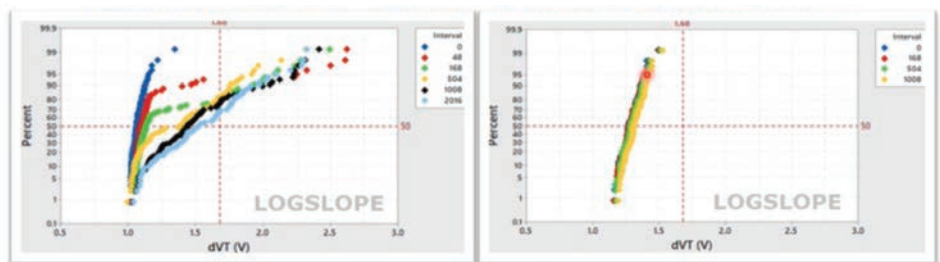
点锡膏实验数据表明，在多次启动-停止之后，包括暂停90分钟后点胶，点胶量也没有显著变化。



Low-Alpha

- 常见的高铅合金 - Pb/Sn5/Ag2.5 & Pb/Sn5
- α 放射量 - <0.01 CPH.CM2
- 兼容多种助焊剂 (例如 NC-SMQ75)
- 减少 α 粒子放射造成的漏电现象

例如：HTGB - Vgs = 20V, T = 150°C, 样品间隔时间@ 0, 48, 168, 504, and 1,008 hours



标准高铅合金

钢泰公司的Low- α 高铅合金

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2023 钢泰公司

表格编号: 100029 (SC A4) R0

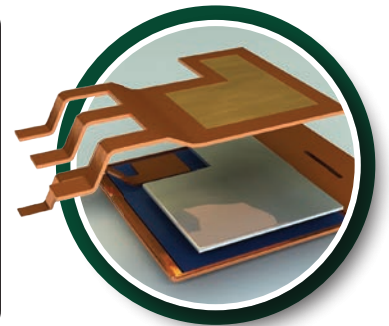
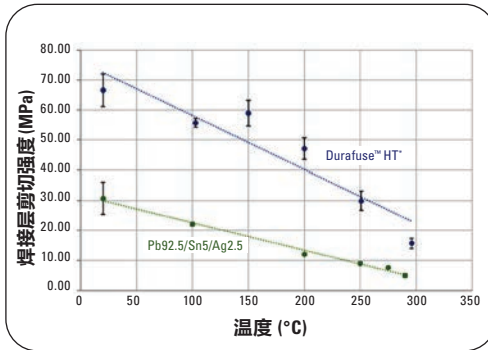
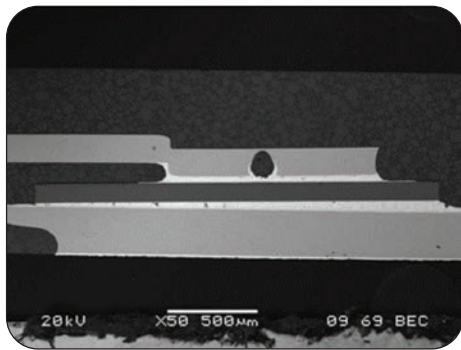
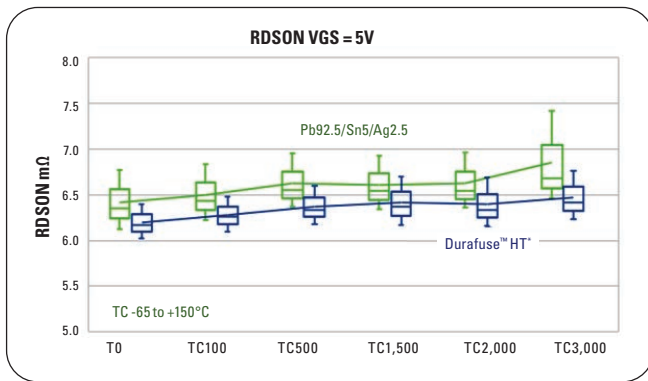
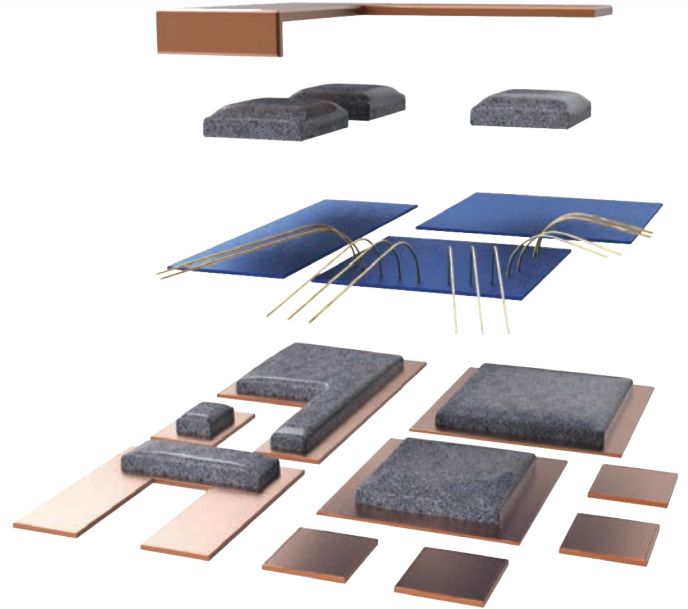


成熟的用于分立式功率封装的高可靠性焊料

高温无铅焊锡膏

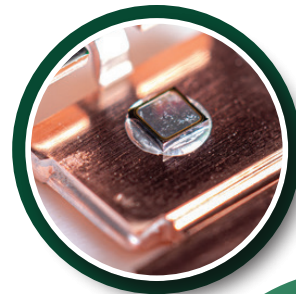
Durafuse™ HT*

- 兼容高铅工艺
- 导热和电气性能与高铅焊料相当甚至优于高铅焊料



QuickSinter®

- 无压银烧结膏作为高铅焊料芯片贴装的替代品
- 加压银烧结膏可用于功率模块芯片到陶瓷基板和基板到散热器之间的连接



*专利申请中

联系我们的工程师: china@indium.com

有关详情: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

所有钢泰公司的焊锡膏和焊片工厂均获得了 IATF 16949:2016 认证
钢泰公司是 ISO 9001:2015 认证的公司

©2023 钢泰公司

表格编号: 100029 (SC A4) R0

